

技術詞彙

本詞彙載有本文件內使用有關本集團及其業務的若干詞彙、定義及縮寫。該等詞彙及其涵義可能不符合該等詞彙的標準行業涵義或用法。

「ABS」	指	丙烯腈丁二烯苯乙烯，一種常見的熱塑性聚合物，與其他常見聚合物相比，具有良好的機械性能，例如抗衝擊性、韌性及剛性
「ASIC」	指	特定應用集成電路。專為滿足客戶特定功能要求而設計及製造的專有集成電路
「ASTM」	指	美國材料與試驗協會(American Society for Testing and Materials)的首字母縮寫，該國際標準組織為廣泛的材料、產品、系統及服務制定及發佈自願共識技術標準，並廣泛應用於半導體行業
「後段半導體傳輸介質」	指	用於製造過程的各階段運輸及容納半導體元件的載體或外殼，一般由精密工程塑膠製成。例如，於元件組裝作業期間、由製造工廠至電路板組裝現場的運輸及存儲期間，以及將元件送入自動貼裝機時用於表面安裝於板上組件上
「BGA」	指	IC封裝設計的球柵陣列封裝(Ball Grid Array)系列的首字母縮寫，使用基板作為互連結構，焊球作為外部連接
「保稅倉庫」	指	海外地區存放無須繳納關稅的應稅貨物的境內倉庫
「載帶」	指	載帶具有順序單個空腔，用於固定各元件，封蓋帶用於密封載帶以將元件保留於空腔中。彼等於搬運及儲存過程中提供機械保護，通常用於將元件送入自動貼裝機，以便於電路板組件上進行表面安裝
「複合年增長率」	指	複合年增長率，評估數值隨時間的平均增長率的方法

技術詞彙

「無塵室」	指	通常用於製造或科學研究的環境，其環境污染物(灰塵、空氣中的微生物、氣溶膠顆粒和化學蒸氣)含量較低
「CPAP」	指	持續氣道正壓通氣 (Continuous Positive Airway Pressure)的首字母縮寫，一種氣道正壓通氣形式，其中持續向人的上呼吸道施加高於大氣壓的恆定壓力水平
「DFN」	指	Dual-Flat-Non-Leaded或「Dual-Flat-No-Lead」的縮寫，一種IC封裝設計結構，於封裝結構的兩個外圍底側有外部信號連接

技術詞彙

「晶粒」	指	在封裝前從晶圓切下的單獨芯片
「EIA」	指	電子工業聯盟(Electronic Industries Alliance)，EIA標準對電子零件及系統的零件標記、建立數據模型、顏色編碼及封裝材料提供指引，根據美國國家標準協會(American National Standards Institute)制定並獲其認可
「EMC」	指	環氧模塑料(Epoxy Molding Compound)的縮寫，為一種被半導體行業廣泛接受的材料，用於封裝精密易碎的引線鍵合矽芯片結構，以保護IC免受外部環境的有害因素的影響
「EMI」	指	電磁干擾(Electromagnetic Interference)的縮寫，為任何電子設備及電氣設備設計工程師於正常使用過程中避免干擾及中斷的關鍵考慮因素
「環氧樹脂」	指	包含兩種常用於電子零件及結構粘合劑的共反應硬化劑的樹脂
「ERAQFN」	指	增強型環形空氣腔四方扁平無鉛(Enhanced-Ring-Air-Cavity Quad Flat Non-lead)的縮寫，為一項專利MEMS及傳感器封裝設計
「ERP」	指	企業資源規劃，為業務流程管理軟件，允許機構使用集成應用程序系統管理業務，並將有關技術、服務及人力資源的後勤功能自動化
「ESD」	指	靜電放電
「無晶圓廠」	指	半導體行業的運營模式，即生產由(i)設計；(ii)IC／晶圓製造；及(iii)IC集成、封裝及測試分割而成
「GFA」	指	總樓面面積
「HVAC」	指	加熱、通風及空調(Heating, Ventilation and Air Conditioning)的首字母縮寫，控制封閉空間內空氣的溫度、濕度及純度的各種技術使用
「IC」	指	集成電路的縮略詞，為將若干電晶體和電子電路組合至一塊矽膠上的半導體器件

技術詞彙

「IDM」	指	集成設備製造商
「IoT」	指	物聯網的縮寫，指由實體設備、車輛、電器及其他實體物件組成的網絡，該等物件嵌入傳感器、軟件及網路連接，令其能夠收集及共享數據
「ISO」	指	國際標準化組織(位於瑞士日內瓦的非政府組織)為評估業務機構質量體系而發佈的一系列質量管理及質量保證標準的縮略詞
「ISO 9001」	指	ISO制定的質量管理體系的國際認可標準。其旨在確保質量管理體系在符合客戶要求方面的成效。其訂明持續改進設計、開發、生產、安裝及服務質量保證的要求
「ISO 14001」	指	ISO制定的國際認可標準，用於實施環境管理體系，可協助公司持續提高其有效識別、盡量減少、預防及管理環境影響的能力
「ISO 45001」	指	ISO制定的國際認可標準，用於職業健康安全管理体系，可透過實行政策及目標，協助公司管理職業健康及安全風險，並提升表現
「JEDEC」	指	聯合電子設備工程委員會 (Joint Electron Device Engineering Council)，JEDEC標準為開放的行業標準，主要為提供公認技術標準及允許不同電子零件之間互用而制定
「LCP-CNT」	指	LCP為液晶聚合物(Liquid Crystal Polymer)的縮寫，CNT為碳納米管(Carbon Nanotube)的縮寫。LCP-CNT乃指以碳納米管為成分的液晶聚合物材料

技術詞彙

「MEMS」	指	微機電系統，使用微細加工及光刻工藝技術製造的小型化機械和機電元件(即設備及結構)。其為製造技術以及設計及創造複雜機械設備和系統的範例
「MPPO」	指	改性PPO，一種混合PPO及多種其他工程熱塑性塑膠的工程熱塑性塑膠，可生產具有廣泛物理及機械性能、耐熱性及阻燃性的材料
「OEM」	指	原始設備製造商
「精密工程塑膠」	指	精密工程塑膠為一種用於工業應用的創新塑膠基材。彼等的設計極其精確且注重細節，可創建精確而複雜的設計，並提供廣泛的特性，例如高強度、耐熱性、高耐用性、高延展性及耐化學性
「PCB」	指	印刷電路板，一種非導電的板基，通過SMT的應用將電子零件安裝在其上，並通過導電跡線連接形成工作電路或組件
「PPO」	指	聚苯醚，一種高溫熱塑性塑膠，具有高耐熱性、尺寸穩定性及準確度以及良好的機械性能，例如抗衝擊性、韌性及剛性
「QFN」	指	四平無鉛(Quad-Flat-Non-Leaded或Quad-Flat-No-Lead)的首字母縮寫，一種IC封裝設計結構，於封裝結構的所有四個外圍底側都有外部信號連接
「研發」	指	研究及開發的縮寫，旨在開發特定技術的科學工作

技術詞彙

「REACH」	指	化學品註冊、評估、授權及限制條例(Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)，自二零零六年十二月十八日起生效的歐盟條例，涉及處理化學物質的生產及使用以及其對人類健康及環境的潛在影響
「RoHS」	指	有害物質限制指令(Restriction of Hazardous Substances Directive) 2002/95/EC，為限制在電氣和電子設備中使用若干有害物質的指令的簡稱，該指令於二零零三年二月獲歐盟採納

技術詞彙

「SMT」	指	表面貼裝技術 (surface-mount technology) 的首字母縮寫，一種構建電子電路的方法，其中組件直接安裝在印刷電路板的表面上
「托盤及托盤相關產品」	指	用於運輸符合JEDEC標準的後段半導體的塑膠容器
「WLCSP」	指	晶圓級芯片規模封裝(Wafer Level Chip Scale Package) 的首字母縮寫詞，一種非常薄且微型的IC封裝結構，通常無環氧模塑料封裝的保護，於流動設備應用中非常流行